

DQL-TP-H800PT

DQL-TP-H800PT具有超高的导热性能，特殊的表面加固使操作人员更容易操作，且在大容量组装过程中无拉丝。

DQL-TP-H800PT具有天然黏性，因此不需要针对热源和散热片添加额外的黏合剂。超软导热垫片的厚度从0.5mm到5.0mm不等。

DQL-TP-H800PT具有良好的柔软性和回弹性，起到很好的降低结构应力，保护芯片的效果。



特性

高导热性，超柔软；高压缩性，天然黏性；填隙能力好；多厚度，应用广

典型应用

通信设备 网络终端 存储设备
功率设备和模块 电动汽车电池

包装方式

片状规格：长*宽*（厚）
400mm*400mm*（0.5≤T<1.0mm）
400mm*200mm*（1.0≤T≤5.0mm）

储藏条件

温度：20-25℃；相对湿度：<65% RH

仓储有效期 18个月

DQL-TP-H800PT性能			
特性	典型值		测试标准
颜色	深蓝色		目测
厚度 (mm) / (mil)	0.5 ~ 1.0/(20 ~ 40)	1.0 ~ 5.0/(40 ~ 200)	ASTM D374
玻璃纤维增强基材	有	无	/
密度 (g/cc)	3.0		ASTM D792
硬度 (Shore OO)	5		ASTM D2240
可持续性工作温度 (°C)	-45 ~ 200		/
电气性能			
击穿强度 (kV) @1mm	> 6		ASTM D149
体积电阻率 (Ω·cm)	4.0×10 ¹⁵		ASTM D257
阻燃等级	V-0		UL94
导热性能			
导热系数 (W/m·K)	8.0		ASTM D5470
热阻(°C·in ² /W)(1mm@10psi)	0.21		ASTM D5470

*注：性能参数基于样品测试仅供参考。